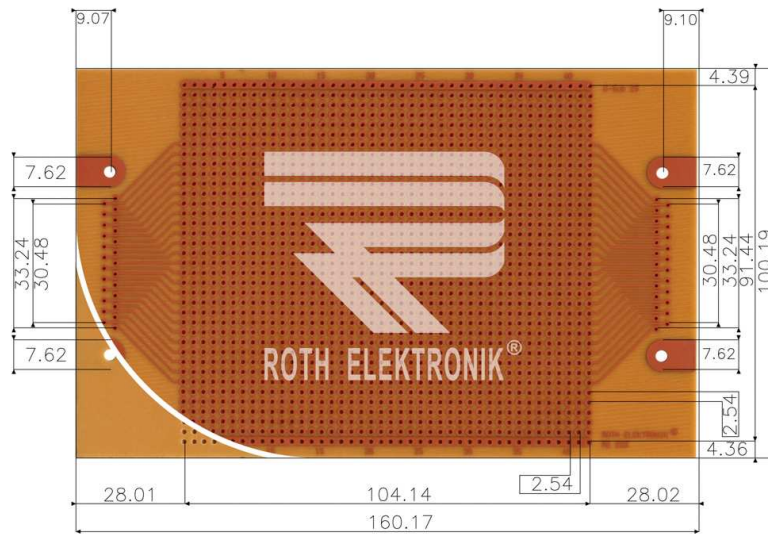


RE225-HP

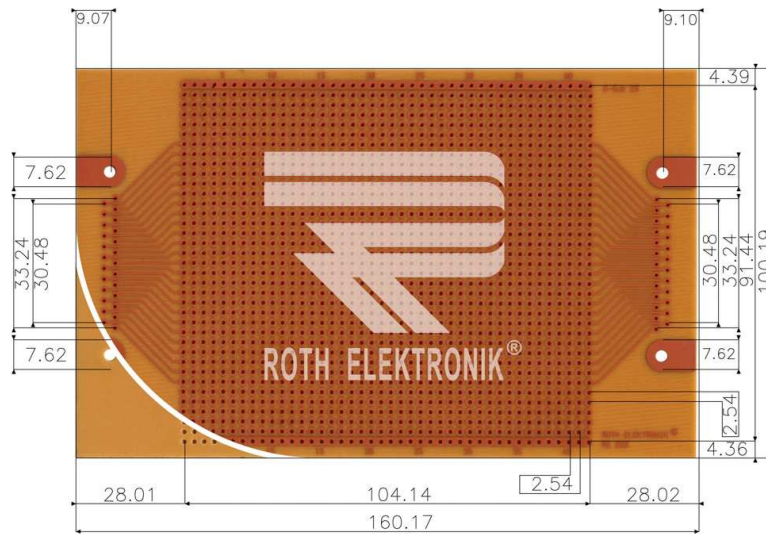
- SRBP paper FR2 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Organic soldering protection (OSP)
- Hole spacing 2.54 x 2.54 mm
- 35 x 42 soldering pads 2.10 mm Ø
- Hole dia 1.00 mm
- Connectors D-Sub DIN 41652 2 x 25-channel
- 2 potential strips
- Size 100 x 160 mm



RE225-HP

- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Organischer Oberflächenschutz (OSP)
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 35 x 42 Lötinseln 2,10 mm Ø
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Steckverbinderanschluss D-Sub DIN 41652 2 x 25-polig
- 2 Potentialbahnen
- Größe 100 x 160 mm

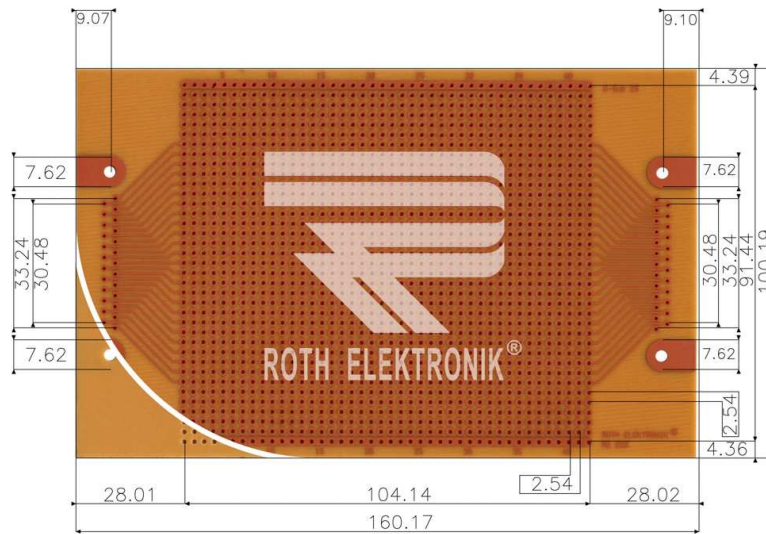
ver.20150130



RE225-HP

- Résine phénolplaste FR2 1,50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Protection organique de la surface (OSP)
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- 35 x 42 îlots de brasage 2,10 mm Ø
- Perforation 1,00 mm Ø
- Connecteur D-Sub DIN 41652 2 x 25-pôles
- 2 pistes potentiel
- Dimensions 100 x 160 mm

ver.20150130



RE225-HP

- Papel endurecido con resina fenolada FR2 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Protección orgánica de la superficie (OSP)
- Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- 35 x 42 nodos de soldadura Ø 2,10 mm
- Diámetro de los agujeros 1,00 mm
- Conector D-Sub DIN 41652 2 x 25 polos
- 2 vías de potencial
- Tamaño 100 x 160 mm